

## 國立交通大學國際半導體產業學院雙聯學位申請表

中文姓名			
英文姓名 (同護照)			
生日	西元	年	月 日
		性別	
聯絡方式	住址: 電話: 手機: Email:		
擬申請學校	<input type="checkbox"/> 美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)		
	<input type="checkbox"/> 日本東京工業大學(TIT)		
	<input type="checkbox"/> 比利時魯汶大學(KU Leuven)		
大學部 學業成績	(百分制) _____ (GPA) _____		
英語能力 檢定	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: (項目) _____ (成績) _____		
<b>備註:</b> 應檢附申請資料 0、 擬申請學校之教授推薦文件(email 可) 1、 中文申請表 1 份 2、 大學部歷年英文成績單 3、 英文簡歷 4、 英文自傳 (A4 格式打字, Times New Roman 12 字體, 單行間距, 1 頁) 5、 英文研究計畫書 (A4 格式打字, Times New Roman 12 字體, 單行間距, 2 頁) 6、 監護人具結同意函 1 份 7、 其他有助審查資料(如外語能力證明、獲獎證明...等)			
申請人簽名及日期		指導教授簽名及日期	
學院審核結果 <input type="checkbox"/> 推薦 <input type="checkbox"/> 不推薦: (請簡述理由) _____ 審核人簽名及日期: _____ 單位主管簽章: _____			

# 國立交通大學國際半導體產業學院雙聯學位申請表

## 家長同意書

### 壹、申請人資料

申請人 姓名		學號	
-----------	--	----	--

### 貳、家長資料

家長姓名		聯絡電話	
同意書內容： 茲同意本人之兒 / 女_____申請 貴校雙聯學位，並且已詳細閱讀雙聯學位說明資料。具結同意於獲審核通過後依 貴校規定赴姊妹校修讀雙聯學位及遵守雙聯學位之相關規定，並支付赴國外學校就讀所需之相關費用(含學費、機票及生活費用等)。 此致 國立交通大學國際半導體產業學院			
家長簽章：		中華民國	年 月 日